

# レーザー&加工装置

Laser Ablation Processing Machine

## 低成本で熱損傷の少ないレーザー加工装置

Cost effective Laser Ablation Processing Machine Causing Less Thermal Damage

### ■ こんなことを解決

- ・短パルスレーザー光源で熱損傷が少ない加工
- ・低成本で光源から加工までのトータルソリューションを提供

### ■ 技術の特徴

#### RICOH独自開発のレーザー光源

- ・ピコ秒からナノ秒までの幅広い範囲を網羅
- ・業界最高レベルの安定出力を構築
- ・パルス幅、周波数などカスタマイズ設定対応可能

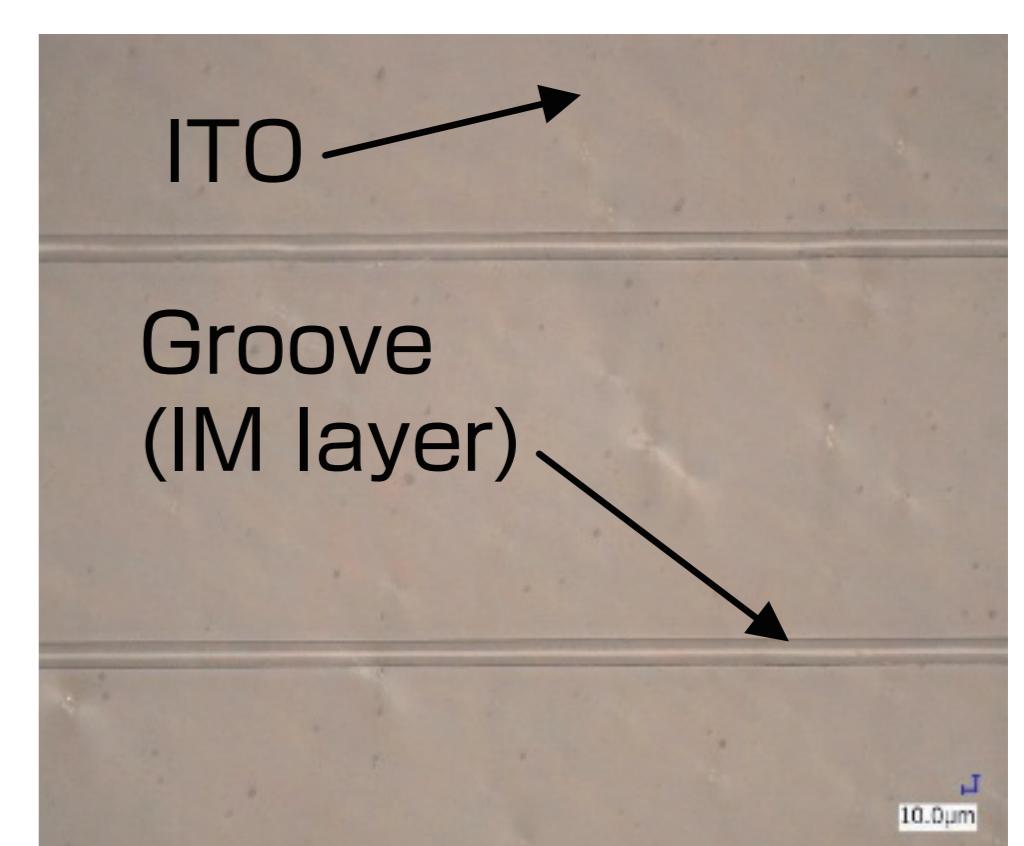
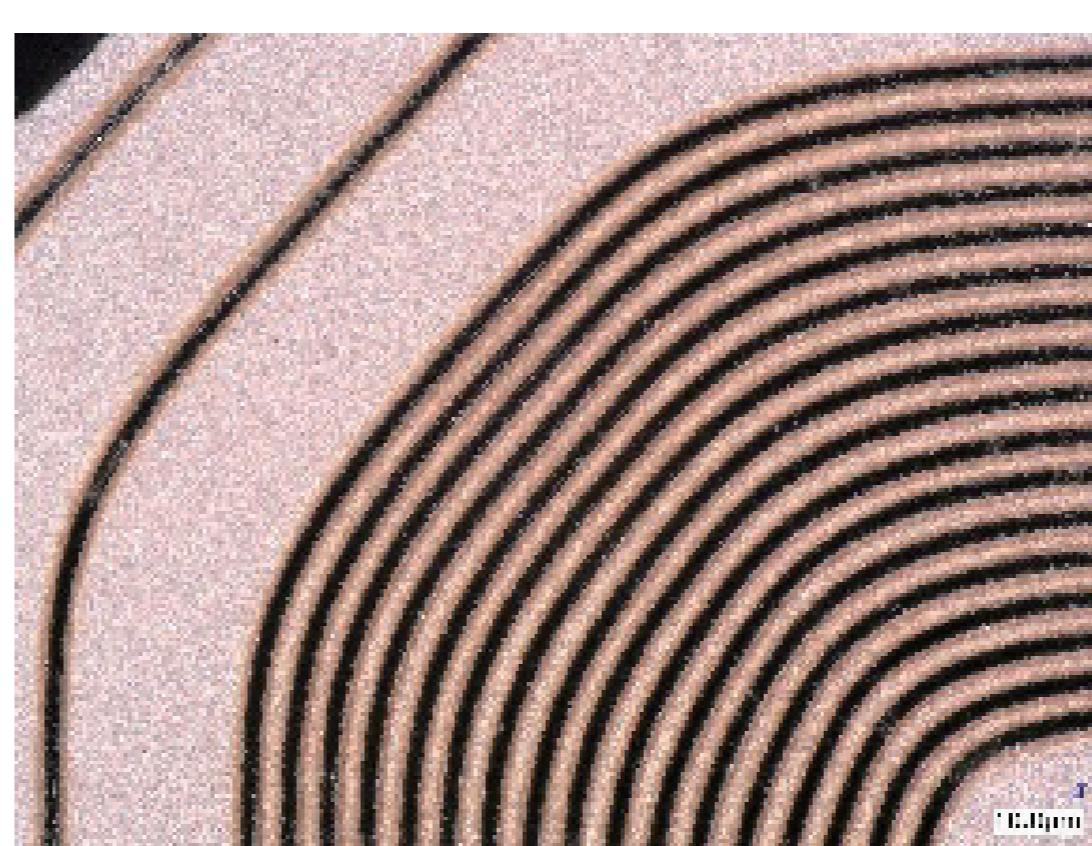


主な仕様

	パラメータ	仕様	単位	備考
ビーム 仕様	波長	1064±3	nm	
	平均出力	<16	W	
	繰り返し周波数	100kHz~4MHz	-	設定調節可能
	パルス幅	50ps~1ns	-	設定調節可能

### ■ リコーの強み

- ・加工範囲600mm幅
- ・スキャンスピード 3000mm/s
- ・平均出力16Wの高出力
- ・L/S 17μm/17μm
- ・加工スポット径 15μm
- ・枚葉式、ロールtoロール、ロールtoシート他



Processing result: L/S 15μm/15μm